



2026年07月13日

标配

晶圆代工涨价延续，美光科技长期资本开支上修至2500亿美元

——电子行业周报2026/7/6-2026/7/12

证券分析师

方霁 S0630523060001

fangji@longone.com.cn

联系人

方逸洋

fyy@longone.com.cn



相关研究

1. 存储涨价效应加速释放，后期价格或高位宽幅震荡——电子行业6月月报
2. 长鑫长存IPO进程加速，华为韬定律提出“时间缩微”技术路径——半导体行业5月份月报
3. 安集科技（688019）：抛光液市占率稳步攀升，“3+1”平台打开增长加速空间——公司深度报告

投资要点：

- 电子板块观点：台积电与三星电子近期上调晶圆代工价格，涨幅5%-15%，由AI需求爆发、先进制程产能满载及资本开支高企驱动。美光科技宣布将在美投资上调至2500亿美元，并宣布其纽约州工厂已提前施工，同时计划向环球晶圆提供5亿美元融资，锁定10年硅晶圆产能。半导体需求在AI驱动下持续旺盛，价格延续上行态势，但估值中枢扩张过快，需警惕中报兑现后的回调风险。建议逢低关注AI算力、存储、光模块及光芯片、算力PCB、AIoT等产业链环节，同时关注半导体设备、零部件、材料、先进封装及模拟芯片涨价等国产替代方向的机遇。
- 近日，全球两大晶圆代工龙头台积电与三星电子先后启动新一轮调价，涨价潮传导至下游晶圆代工环节。台积电已通知英伟达、苹果、AMD等核心客户，计划将3nm、5nm及7nm制程价格上调5%-10%，覆盖其七成以上晶圆代工营收。三星电子紧随其后，针对4nm、5nm先进制程及部分车规8nm制程，将新客户供货价格提高约15%。与过往良率稳定后价格逐步下调的惯例不同，本轮涨价核心驱动力为AI芯片订单持续放量，导致先进制程产能长期满载，叠加HBM产能挤占效应与2nm等下一代制程研发及设备投资成本走高，市场供需与投资成本分摊正取代工艺成熟度成为定价主导因素。台积电引领了根据市场状况重新调整节点价格的趋势，而三星更多是针对特定需求集中节点的价格正常化，两者策略虽有差异，但均反映晶圆代工正从“抢客户”的买方市场向“供应商主导定价”的卖方市场转变。这一变化将推高AI芯片及终端产品制造成本，除晶圆涨价外，HBM价格攀升与先进封装产能紧缺，预计将共同抬升英伟达、苹果等公司的成本压力，并可能最终传导至AI服务器及智能手机等终端产品价格。
- 美光科技大幅上调在美投资至2500亿美元，本土产能建设提速。7月9日，美光科技宣布将2035年前在美投资目标由2000亿美元上调至超过2500亿美元，覆盖纽约州、爱达荷州及弗吉尼亚州等多个项目。同日，美光位于纽约州的克莱工厂完成首次混凝土浇筑，较原计划提前逾一个季度，该工厂系美国历史上最大半导体制造基地，此次节点突破标志着项目从场地准备正式转入地面施工阶段。美光预计，本轮扩产完成后，公司将实现美国本土DRAM产能占全球供给40%的长期目标。此外，美光拟投入最高30亿美元用于强化本土供应链生态，其中向环球晶圆提供5亿美元战略融资，以支持其得克萨斯州300毫米硅晶圆制造设施的产能建设。双方同步签署为期10年的长期供货协议，锁定硅晶圆产能以保障美光远期制造需求，并计划在下一代晶圆技术领域探索合作空间。环球晶圆是目前唯一在美国本土具备先进300毫米晶圆生产能力的硅材料供应商，合作有助于双方共同提升本土制造与供应体系的稳定性。美光本轮大幅上调资本开支，进一步印证了全球存储芯片行业正处于HBM及先进DRAM的扩产景气周期，对产业链上游设备、材料及封测环节的订单能见度形成有力支撑。
- 电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数下跌1.27%，申万电子指数下跌1.66%，跑输大盘0.39点，涨跌幅在申万一级行业中排第12位，PE(TTM)95.55倍。截至7月10日，申万电子二级子板块涨跌：半导体(+1.86%)、电子元器件(-6.79%)、光学光电子(-8.67%)、消费电子(-2.92%)、电子化学品(-7.47%)、其他电子(-1.78%)。海外方面，台湾电子指数下跌2.08%，费城半导体指数上涨2.70%。
- 投资建议：行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或持续持续。目前存储价格过高对手机类消费电子需求压制或较为显著，当前估值也处于历史高

分位水平。综合考虑，我们认为AI基建高景气或持续，半导体国产化依然加速发展，但估值增长过快，短期警惕利好兑现调整的风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会为主。建议关注：（1）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息、澜起科技、摩尔线程、沐曦股份、龙芯中科；光器件关注源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、东山精密；PCB板块关注胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技等；存储关注江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正；服务器与液冷关注英维克、中石科技、飞荣达、思泉新材、工业富联。（2）受益海内外需求强劲AIOT领域的乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、泰凌微。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零部件、材料产业，关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、富创精密、新莱应材、中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材。（4）价格触底复苏的龙头标的，关注功率板块的新洁能、扬杰科技、东微半导体；CIS的豪威集团、思特威、格科微；模拟芯片的圣邦股份、思瑞浦、美芯晟、芯朋微等。

- 风险提示：（1）下游需求复苏不及预期风险；（2）国产替代进程不及预期风险；（3）AI资本开支不及预期风险。

正文目录

1. 行业新闻	5
2. 上市公司重要公告	7
2.1. 上市公司重要公告	7
2.2. 上市公司 2025 年年度报告	8
3. 周行情回顾	9
4. 行业数据追踪	12
5. 风险提示	14

图表目录

图 1 申万一级行业指数周涨跌幅（%）	9
图 2 申万行业二级板块指数涨跌幅（截至 2026/7/10）	9
图 3 申万行业二级板块指数估值（截至 2026/7/10）	9
图 4 电子指数组合图（截至 2026/7/10）	10
图 5 申万三级细分板块周涨跌幅（%）	10
图 6 本周电子行业各子版块涨跌幅前三个股	11
图 7 本周美股主要科技股信息更新（截至 2026/7/10）	11
图 8 2024 年 7 月 10 日-2026 年 7 月 10 日 DRAM 现货平均价（美元）	12
图 9 2024 年 1 月-2026 年 5 月 NAND FLASH 合约平均价（美元）	12
图 10 2023 年 7 月 7 日-2026 年 7 月 7 日 LPDDR4/4X 市场平均价（美元）	13
图 11 2023 年 7 月 6 日-2026 年 7 月 6 日 TV 面板价格（美元）	13
图 12 2022 年 7 月-2026 年 7 月笔记本面板价格（美元）	13
图 13 2022 年 7 月-2026 年 7 月显示面板价格（美元）	13
表 1 上市公司重要公告	7
表 2 上市公司 2026 半年度业绩预告	8

1. 行业新闻

1) AI 投资扩张推动台积电、三星涨价

据韩媒 ChosunBiz 今天(9 日)报道,随着 AI 芯片投资持续扩大,晶圆代工市场的定价格局开始改变。继去年上调先进制程价格后,台积电今年启动了新一轮调价,三星也提高了部分制程的供货价格。业界消息称台积电最近已通知英伟达、苹果和 AMD 等主要客户,计划上调晶圆供货价格 5%至 10%。涨价范围不仅包括 3 纳米、5 纳米等尖端制程,也包括用于生产高性能芯片的 7 纳米制程。三星电子晶圆代工业务也出现类似变化。据了解,三星已面向新客户将供货价格上调了约 15%,涨价重点集中在 4 纳米、5 纳米等需求较高的先进制程,以及部分车用 8 纳米制程。(信息来源:同花顺财经)

2) SK 海力士正式在美股上市,募资 265 亿美元创历史纪录

当地时间 7 月 10 日,韩国半导体巨头 SK 海力士正式在美国纳斯达克挂牌交易。此次发行的美国存托凭证(ADR)共募集资金 265 亿美元,超过 2014 年阿里巴巴的 250 亿美元的上市规模,成为美股历史上规模最大的外国企业首次公开募股。SK 海力士在美股上市,预计将对全球存储芯片行业的估值格局与扩产周期产生长远影响。(信息来源:同花顺财经)

3) 美光科技计划 2035 年前将投资总额增至 2500 亿美元

7 月 9 日,美光科技宣布,得益于人工智能时代对内存需求的激增,计划在 2035 年前将对美国本土的投资总额增至超过 2500 亿美元。公司目标是将美国产能占其 DRAM 总产量的比例提升至 40%。此次扩大投资反映了美光对其技术领导地位的信心以及对其尖端内存产品的持续需求。(信息来源:同花顺财经)

4) 三星电子加速晶圆厂建设

据媒体报道,三星电子正计划将位于韩国京畿道龙仁半导体国家产业园区建设提速,使其投产时间比原计划提前一至两年,目标 2029 年实现量产运营。据悉,三星电子原计划于 2030 年至 2031 年让园区内 6 座晶圆厂中的首座投入运营。而如今,在韩国政府加速园区开发的政策推动下,整体建设周期全面压缩。韩国总统本月 6 日主持召开大型项目公私联合推进会,已就龙仁园区工期前置方案开展专项讨论。按照 2029 年投产目标倒排工期,业内测算,地块平整等前期配套工程需于今年下半年全面启动,厂房主体土建建设工程 2027 年必须开工。(信息来源:同花顺财经)

5) 苹果与博通达成价值超 300 亿美元的芯片采购协议

苹果宣布与博通达成一项新的多年期协议,计划未来五年向博通采购价值超过 300 亿美元的美国制造芯片。这项协议预计将实现超 150 亿颗美国制造的芯片量产,并支持数百个美国就业岗位。该协议还包含,博通将投入 15 亿美元扩建和升级其位于美国科罗拉多州柯林斯堡的制造设施。博通将在该工厂生产先进射频组件,包括 FBAR 滤波器以及各种无线连接技术。不过苹果并未透露新增产能预计何时能够投入运营。(信息来源:同花顺财经)

6) 托伦斯在创业板上市,公开发行市值 10.48 亿元

7 月 10 日,新股托伦斯将在创业板上市,股票代码为 301583.SZ,发行价为 22.60 元,网上发行量为 1622.90 万股,网下发行为 1622.89 万股,市盈率为 686.27。从公司业务来看,托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司的主营业务是半导体及激光设备精密零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品有半导体关键工艺零部件、半导体工艺零部件、半导体结构零部件产品。公司作为国内领先的半导体设备精密金属零部件,凭借自身综合实力已获评国家级专精特新重点“小巨人”、国家级专精特新“小巨人”、江苏省先进级智能工厂、江苏省省级企业技术中心、江苏省专精特新中小企业等荣誉称号。(信息来源:同花顺财经)

7) Omdia: 中国半导体市场规模将在 2026 年超过 8000 亿美元 存储芯片市场总额暴涨 262.9%

7 月 7 日, 根据 Omdia 《2026 年第二季度, 半导体应用领域市场预测工具 (AMFT) - 中国地区》最新报告数据显示, 2026 年中国半导体市场预计同比增长率将大幅上修至 92.9%, 达 8120.8 亿美元, 2026 年中国半导体存储市场预计增长率大幅上修至 262.9%, 达 4496 亿美元。(信息来源: 同花顺财经)

8) 安森美出售两座工厂

7 月 7 日, 安森美正式宣布资产剥离计划。为了降低成本并优化集团整体制造成本结构, 将出售旗下两座分别位于美国与菲律宾的工厂, 落实“精准建厂 (Fab Right)”战略。其中, 安森美已与中国台湾半导体封装测试企业超丰电子 (Greatek Electronics) 达成协议, 将出售菲律宾塔拉克工厂。交易尚需满足常规交割条件并通过监管审批, 预计交割周期为 3 至 6 个月。另一座美国工厂则作价出售给瑞典半导体企业 Silex Microsystems, 交易需完成常规交割条件与监管审批, 预计 2028 年 1 月正式交割。根据测算, 上述两项资产剥离预计每年可节省约 3500 万美元的成本, 初步节省将于 2027 年开始, 全部节省将于 2028 年实现。(信息来源: 同花顺财经)

9) 燧原科技获证监会科创板 IPO 注册批复

中国证监会于 2026 年 7 月 9 日正式发布批复文件, 同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。燧原科技专注于云端人工智能芯片研发, 目前已构建涵盖 AI 芯片、AI 加速卡及模组、智算系统集群、AI 计算编程软件平台在内的完整产品体系。财务方面, 2023 年至 2025 年, 公司营业收入由 3.01 亿元增长至 9.90 亿元, 三年复合增长率达 81%。其中, AI 加速卡及模组产品收入由 1.86 亿元增至 8.56 亿元, 增幅超过 360%。同期, 净亏损由 16.65 亿元收窄至 11.64 亿元, 亏损规模持续改善。(信息来源: 同花顺财经)

10) 三星电子第二季度营业利润同比飙升 19 倍

三星电子发布第二季度初步财报, 期内营业利润同比飙升 19 倍, 达到 89.4 万亿韩元 (约 580 亿美元), 大幅超越分析师此前预期的 84.2 万亿韩元, 甚至高于 2025 年全年业绩; 营收达 171 万亿韩元, 同样超出市场预期。本季业绩的爆发式增长直接受益于 AI 数据中心对高端存储芯片的迫切需求。汇丰银行数据显示, 第二季度 DRAM 平均售价环比涨幅超 40%, NAND 闪存价格涨幅超 50%; 由于产能优先向高端芯片倾斜, 普通存储芯片同样陷入严重短缺, 正进一步推高下游消费电子终端产品的价格。(信息来源: 同花顺财经)

2.上市公司重要公告

2.1.上市公司重要公告

表1 上市公司重要公告

公司名称	公告类型	公司公告
拓荆科技 688072.SH	资产重组	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买无锡尚积 82.97%股份、上海泰纳微 100%股权和无锡宽行 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易后，上市公司将直接及间接持有无锡尚积 100%股份。
中微公司 688012.SH	资产重组	公司拟通过发行股份及支付现金的方式向杭州众芯硅、宁容海川、临安众芯硅、临安众硅、杭州芯匠、杭州众诚芯等 41 名交易对方购买杭州众硅 64.69%股权。本次交易完成后，杭州众硅将成为上市公司控股子公司。
晶合集成 2249.HK	H 股上市	经香港联交所批准，公司本次发行的 2.16 亿股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 7 月 10 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。
光迅科技 002281.SZ	筹划 H 股上市	为深化公司全球化战略布局，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，打造公司多元化融资渠道，助力公司高质量发展，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟筹划在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市。
东微半导 688261.SH	发行可转换公司债券	本次拟发行可转债不超过 1435.88 万张（面值 100 元/张），募集总额不超过人民币 14.36 亿元，期限六年，转股后在科创板上市。具体发行规模授权董事会根据财务状况及市场情况确定。
唯捷创芯 688153.SH	限售股上市	公司本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 889.16 万股，上市流通日期为 2026 年 7 月 20 日。
立讯精密 2475.HK	H 股上市	经香港联交所批准，公司本次发行的 3.83 亿股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 7 月 9 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。
三环集团 6951.HK	H 股上市	经香港联交所批准，公司本次发行的 0.71 亿股 H 股股票（行使超额配售权之前）于 2026 年 7 月 9 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。
三孚新科 688359.SH	对外投资	公司拟与广东三孚控股有限公司、自然人肖瑶、自然人邓钧玮、自然人崔成强设立广州德胜祥电子材料制造有限公司（暂定名，以工商登记机构核准的公司名称为准），合资公司主要从事高端电子铜箔的研发、生产及销售，注册资本暂定为 5,000 万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资 1,500 万元，占合资公司注册资本的 30%。
神工股份 688233.SH	新项目建设投资	公司本项目投资总额约为 11.30 亿元（以实际投入为准），其中“硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目”拟投资金额为 5.86 亿元；“集成电路制造关键材料研发及产业化项目”拟投资金额为 3.26 亿元；“封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目”拟投资金额为 2.18 亿元。

资料来源：同花顺，东海证券研究所

2.2.上市公司 2025 年年度报告

表2 上市公司 2026 半年度业绩预告

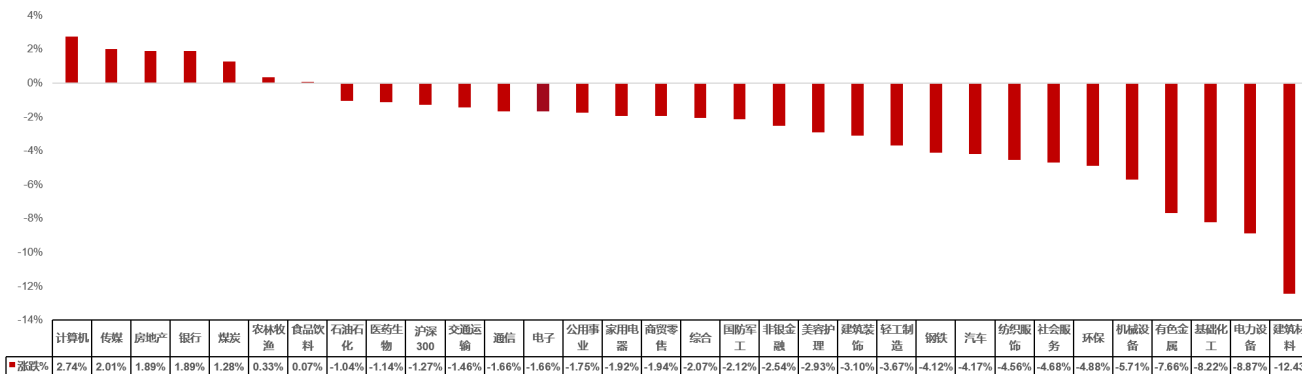
公司名称	公告类型	公司公告
兆易创新 603986.SH	2026 年中报业绩预告	公司预计 2026 年半年度实现营业收入约 115.00 亿元，同比增长约 177%；预计归母净利润约 69 亿元，同比增长约 1099%；预计扣非净利润约 48.50 亿元，同比增长约 791%。
瑞芯微 603893.SH	2026 年中报业绩预告	公司预计 2026 年半年度实现营业收入 28.70 亿元至 29.10 亿元，同比增长 40.28%到 42.24%；预计实现归母净利润 8.50 亿元到 9.10 亿元，同比增长 60.03%到 71.33%；预计实现扣非净利润 8.30 亿元到 8.90 亿元，同比增长 60.93%到 72.56%。
鼎龙股份 300054.SZ	2026 年中报业绩预告	公司预计实现营业收入 19.25 亿元，同比增长约 11%；预计实现归母净利润 5.1 亿元到 5.4 亿元，同比增长 63.96%到 73.61%。
全志科技 300458.SZ	2026 年中报业绩预告	公司预计实现归母净利润 4.75 亿元到 5.15 亿元，同比增长 194.73%到 219.55%；预计实现扣非净利润 4.35 亿元到 4.65 亿元，同比增长 222.46%到 244.70%。
京东方 A 000725.SZ	2026 年中报业绩预告	公司预计实现归母净利润 50.00 亿元到 55.00 亿元，同比增长 54%到 69%；预计实现扣非净利润 30.80 亿元到 33.10 亿元，同比增长 35%到 45%。
复旦微电 688385.SH	2026 年中报业绩预告	公司预计营业收入 22.00 亿元至 24.00 亿元，同比增加 19.64%至 30.52%；预计实现归母净利润 8.00 亿元至 10.00 亿元，同比增加 313.19%至 416.49%；预计扣非净利润 3.50 亿元到 4.50 亿元，同比增加 91.98%至 146.83%。
香农芯创 300475.SZ	2026 年中报业绩预告	公司预计实现归母净利润 35.00 亿元到 40.00 亿元，同比增长 2117.54%到 2434.34%；预计实现扣非净利润 33.90 亿元到 38.90 亿元，同比增长 2073.15%到 2393.67%。
鸿富瀚 301086.SZ	2026 年中报业绩预告	公司预计实现归母净利润 0.73 亿元到 0.83 亿元，同比增长 221.13%到 265.13%；预计实现扣非净利润 0.69 亿元到 0.79 亿元，同比增长 230.05%到 277.88%。
艾比森 300389.SZ	2026 年中报业绩预告	公司预计实现归母净利润 1.36 亿元到 1.60 亿元，同比增长 17.11%到 37.78%；预计实现扣非净利润 0.71 亿元到 0.95 亿元，同比下降 11.97%到 34.32%。
广合科技 001389.SZ	2026 年中报业绩预告	公司预计实现归母净利润 9.1 亿元到 9.6 亿元，同比增长 85.12%到 95.29%；预计实现扣非净利润 8.9 亿元到 9.4 亿元，同比增长 86.37%到 96.84%。

资料来源：同花顺，东海证券研究所

3.周行情回顾

本周沪深 300 指数下跌 1.27%，申万电子指数下跌 1.66%，跑输大盘 0.39 点，涨跌幅在申万一级行业中排第 12 位，PE(TTM)95.55 倍。

图1 申万一级行业指数周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，东海证券研究所

截至 7 月 10 日，申万电子二级子板块涨跌：半导体(+1.86%)、电子元器件(-6.79%)、光学光电子(-8.67%)、消费电子(-2.92%)、电子化学品(-7.47%)、其他电子(-1.78%)。海外方面，台湾电子指数下跌 2.08%，费城半导体指数上涨 2.70%。

图2 申万行业二级板块指数涨跌幅（截至 2026/7/10）

2026/7/10		板块	收盘价	周涨跌幅	涨跌幅 30日涨跌幅	年初至今
指数	代码					
申万电子二级 指数	801081.SI	半导体	12,982.16	1.86%	26.79%	86.78%
	801083.SI	电子元器件	25,105.89	-6.79%	-3.55%	83.62%
	801084.SI	光学光电子	2,164.43	-8.67%	-0.28%	29.86%
	801085.SI	消费电子	11,462.79	-2.92%	-2.65%	14.11%
	801086.SI	电子化学品	14,777.91	-7.47%	15.73%	93.23%
大盘指数	801082.SI	其他电子	21,078.84	-1.78%	10.34%	35.00%
	000001.SH	上证指数	3,996.16	-1.17%	-0.35%	0.69%
	399001.SZ	深证成指	15,046.67	-3.53%	-1.45%	11.25%
	399006.SZ	创业板指	3,842.73	-4.41%	-3.00%	19.97%
	000300.SH	沪深300	4,780.79	-1.27%	-0.44%	3.26%
行业指数	801080.SI	电子(申万)	10,841.16	-1.66%	13.34%	65.41%
	TWSE071.TW	台湾电子指数	1,554.72	-2.08%	4.24%	69.49%
	SOX.GI	费城半导体指数	12,967.16	2.70%	2.44%	83.07%

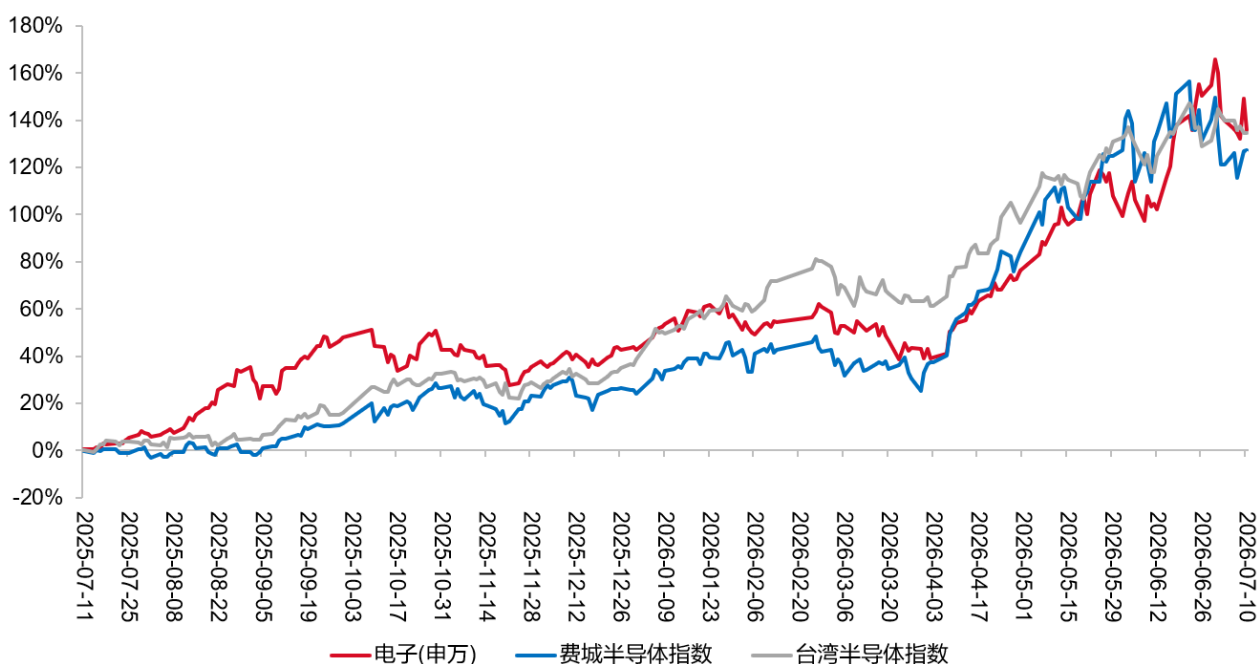
资料来源：Wind，东海证券研究所

图3 申万行业二级板块指数估值（截至 2026/7/10）

2026/7/10		板块	PE (TTM)	PE估值		PS (TTM)	PS估值		PB (MRQ)	PB估值	
指数	代码			历史分位数 (5y)	历史分位数 (10y)		历史分位数 (5y)	历史分位数 (10y)		历史分位数 (5y)	历史分位数 (10y)
申万电子二级指 数	801081.SI	半导体	148.44	99.50%	98.58%	19.45	99.59%	99.79%	22.29	99.26%	99.63%
	801083.SI	电子元器件	88.99	98.43%	99.22%	8.93	98.18%	99.09%	13.78	98.31%	99.16%
	801084.SI	光学光电子	71.20	92.73%	90.94%	2.25	99.50%	80.22%	7.22	98.76%	94.11%
	801085.SI	消费电子	40.94	93.97%	72.23%	1.69	82.31%	53.77%	7.85	92.93%	65.22%
	801086.SI	电子化学品	124.76	98.68%	99.34%	12.28	98.68%	99.34%	11.08	98.68%	99.34%
大盘指数	801082.SI	其他电子	75.00	86.32%	91.22%	2.09	96.94%	78.24%	15.39	98.84%	99.42%
	000001.SH	上证指数	16.90	91.57%	95.63%	1.51	91.57%	95.39%	7.36	78.02%	60.12%
	399001.SZ	深证成指	35.87	96.61%	98.31%	2.20	86.12%	65.88%	3.05	84.30%	69.80%
	399006.SZ	创业板指	48.82	78.51%	63.74%	4.85	77.27%	57.40%	6.50	83.88%	80.10%
	000300.SH	沪深300	14.35	93.88%	86.07%	1.56	90.33%	92.01%	9.62	67.77%	47.38%
行业指数	801080.SI	电子(申万)	95.55	99.17%	99.59%	5.52	99.26%	99.63%	17.20	99.09%	99.55%
	SOX.GI	费城半导体指数	42.94	57.10%	73.63%	17.50	97.29%	98.33%	15.78	97.45%	98.43%

资料来源：Wind，东海证券研究所

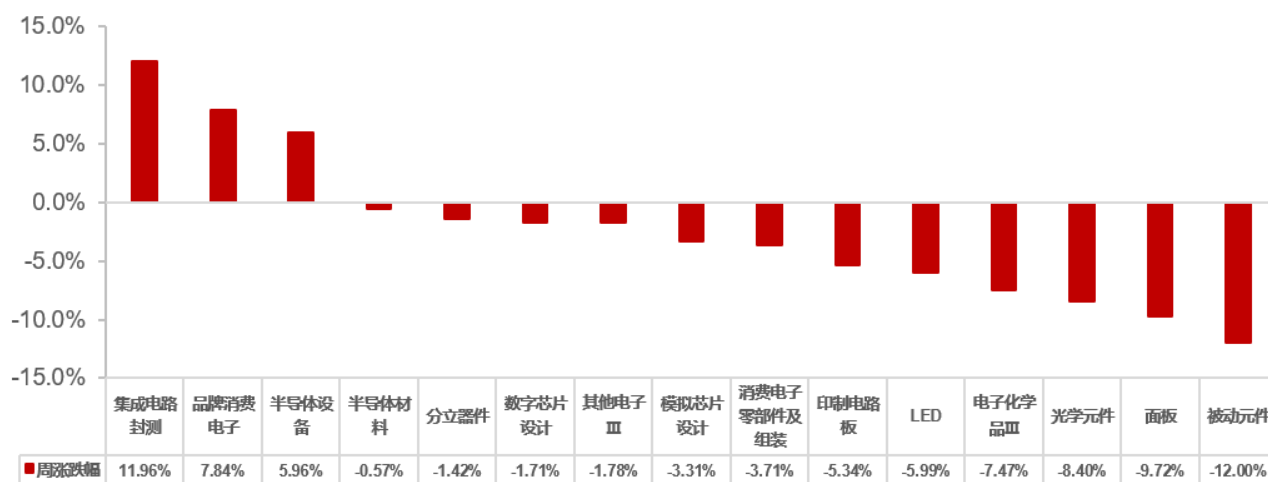
图4 电子指数组合图（截至 2026/7/10）



资料来源：Wind，东海证券研究所

本周半导体细分板块涨跌幅分别为：集成电路封测（+11.96%）、品牌消费电子（+7.84%）、半导体设备（+5.96%）、半导体材料（-0.57%）、分立器件（-1.42%）、数字芯片设计（-1.71%）、其他电子Ⅲ（-1.78%）、模拟芯片设计（-3.31%）、消费电子零部件及组装（-3.71%）、印制电路板（-5.34%）、LED（-5.99%）、电子化学品Ⅲ（-7.47%）、光学元件（-8.40%）、面板（-9.72%）、被动元件（-12.00%）。

图5 申万三级细分板块周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，东海证券研究所

图6 本周电子行业各子版块涨跌幅前三个股

大类	证券代码	分类	证券名称	周涨跌幅前三	30日涨跌幅
半导体	688584.SH	半导体材料	上海合晶	35.77%	48.97%
	688432.SH	半导体材料	有研硅	34.16%	149.84%
	688347.SH	集成电路制造	华虹宏力	29.78%	62.65%
	920179.BJ	半导体材料	凯德石英	-22.75%	-2.56%
	688286.SH	模拟芯片设计	敏芯股份	-20.17%	5.71%
	688661.SH	半导体材料	和林微纳	-19.49%	22.74%
电子元器件	002815.SZ	印制电路板	崇达技术	21.59%	-0.99%
	301251.SZ	印制电路板	威尔高	12.57%	7.11%
	002384.SZ	印制电路板	东山精密	4.11%	7.98%
	920981.BJ	被动元件	晶赛科技	-22.03%	-11.90%
	688020.SH	印制电路板	方邦股份	-21.40%	30.68%
	300319.SZ	被动元件	麦捷科技	-21.24%	-14.97%
光学光电子	301321.SZ	面板	翰博高新	15.36%	63.08%
	002137.SZ	LED	实益达	15.36%	11.40%
	301379.SZ	面板	天山电子	10.70%	46.62%
	300120.SZ	面板	经纬辉开	-22.71%	-11.10%
	300545.SZ	面板	联得装备	-22.10%	-11.21%
	688322.SH	光学元件	奥比中光	-20.59%	-21.16%
消费电子	002841.SZ	品牌消费电子	视源股份	36.80%	50.50%
	920857.BJ	消费电子零部件及组装	泓禧科技	27.46%	-7.88%
	920267.BJ	消费电子零部件及组装	鑫汇科	26.15%	8.49%
	002635.SZ	消费电子零部件及组装	安洁科技	-25.68%	1.76%
	301067.SZ	消费电子零部件及组装	显盈科技	-19.94%	-11.11%
	603626.SH	消费电子零部件及组装	科森科技	-17.95%	-26.71%
其他电子Ⅲ	688103.SH	其他电子Ⅲ	国力电子	41.08%	69.69%
	301099.SZ	其他电子Ⅲ	雅创电子	9.75%	21.71%
	001287.SZ	其他电子Ⅲ	中电港	8.46%	16.48%
	002729.SZ	其他电子Ⅲ	好利科技	-20.28%	-18.26%
	688662.SH	其他电子Ⅲ	富信科技	-19.29%	-17.61%
	002388.SZ	其他电子Ⅲ	新亚制程	-17.31%	-11.24%
电子化学品Ⅲ	688371.SH	电子化学品Ⅲ	菲沃泰	17.35%	22.45%
	300684.SZ	电子化学品Ⅲ	中石科技	12.26%	28.17%
	688019.SH	电子化学品Ⅲ	安集科技	10.02%	45.88%
	688549.SH	电子化学品Ⅲ	中巨芯	-19.11%	29.44%
	300285.SZ	电子化学品Ⅲ	国瓷材料	-18.33%	11.60%
	300537.SZ	电子化学品Ⅲ	广信材料	-17.57%	-5.92%

资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

我们选取了较有代表性的部分美股科技股，并将相关信息更新如下。本周涨幅较大的为博通（+10.96%）、Lumentum 控股（+10.12%）、英伟达（+8.28%）。

图7 本周美股主要科技股信息更新（截至 2026/7/10）

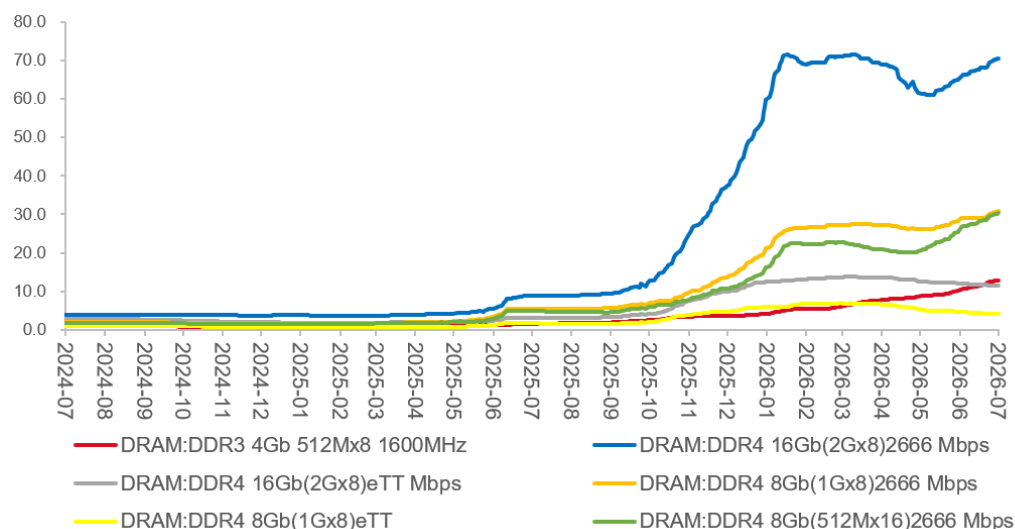
证券代码	证券简称	所属OICS子行业	市值 (亿美元)	周涨跌幅	月涨跌幅	年涨跌幅	PE (TTM)	PB (MRQ)	营收(亿美元)					归母净利润(亿美元)				
									2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1
AVGO.O	博通	半导体产品	19028.89	10.96%	5.88%	15.99%	64.91	21.70	149.16	150.04	159.52	180.15	193.11	55.03	49.65	41.40	85.18	73.49
LITE.O	Lumentum 控股	通信设备	623.96	10.12%	-6.53%	117.59%	142.39	73.70	4.25	4.81	5.34	6.66	8.08	-0.44	2.13	0.04	0.78	1.43
NVDA.O	英伟达	半导体产品	51052.32	8.28%	5.43%	13.25%	31.99	50.99	440.62	467.43	570.06	681.27	816.15	187.75	264.22	319.10	429.60	583.21
AMD.O	超威半导体	半导体产品	9096.96	7.74%	-3.96%	160.50%	181.61	14.11	74.38	76.85	92.46	102.70	102.53	7.09	8.72	12.43	15.11	13.83
QCOM.O	高通	半导体产品	1993.75	7.32%	2.36%	11.71%	20.09	7.31	109.79	103.65	112.70	122.52	105.99	28.12	26.66	-31.17	30.04	73.70
NXPI.O	恩智浦	半导体产品	737.87	6.91%	4.00%	35.80%	27.81	6.75	28.35	29.26	31.73	33.35	31.81	4.90	4.45	6.31	4.55	11.22
TXN.O	德州仪器	半导体产品	2834.58	6.27%	4.49%	81.62%	53.12	16.89	40.69	44.48	47.42	44.23	48.25	11.79	12.95	13.64	11.63	15.45
ON.O	安森美半导体	半导体产品	376.07	5.20%	1.50%	77.21%	65.55	5.15	14.46	14.69	15.51	15.30	15.13	-4.85	1.70	2.55	1.82	-0.33
ADI.O	亚德诺	半导体产品	1927.16	4.90%	-0.38%	48.75%	58.16	5.71	24.23	26.40	28.80	30.78	31.60	3.91	5.70	5.19	7.88	8.31
ARM.O	Arm Holdings	半导体产品	3454.06	2.57%	-8.79%	195.35%	382.09	46.83	12.41	10.53	11.35	12.42	14.90	2.10	1.30	2.38	2.23	3.13
AAPL.O	苹果	电子产品、消费电子及计算机周边设备	46312.17	2.17%	8.97%	16.20%	37.78	43.49	953.59	940.36	1024.66	1437.56	1111.84	247.80	234.34	274.66	420.97	295.78
ASXN	日月光投控	半导体产品	951.50	1.89%	-4.75%	166.84%	64.54	8.70	44.07	50.94	54.70	56.72	53.47	2.35	2.63	3.73	4.79	4.54
ASML.O	阿斯麦	半导体材料与设备	6927.19	1.58%	-9.66%	68.50%	60.08	28.87	83.89	89.95	87.80	113.86	101.04	25.52	26.79	24.82	33.27	31.77
AMZN.O	亚马逊	多品类零售	26391.49	1.10%	2.94%	6.29%	29.07	5.97	1556.67	1677.02	1801.69	2133.86	1815.19	171.27	181.64	211.87	211.92	302.55
ORCLN	甲骨文	系统软件	4051.09	0.61%	-3.70%	-27.15%	23.85	13.53	141.30	159.03	149.26	160.58	171.90	29.36	34.27	29.27	61.35	37.21
MU.O	美光科技	半导体产品	11060.15	0.38%	-15.15%	243.82%	21.91	15.26	80.53	93.01	113.15	136.43	238.60	15.83	18.85	32.01	52.40	137.85
TSMN	台积电	半导体产品	22515.00	-0.01%	-9.10%	43.43%	37.41	12.25	255.81	321.93	330.97	332.04	353.54	110.21	137.31	151.04	160.53	178.46
GOOGL.O	谷歌A	互动媒体与服务	43483.09	-0.76%	-0.05%	14.26%	27.14	9.08	902.34	964.28	1023.46	1138.28	1098.96	345.40	281.96	349.79	344.55	625.78
MSFT.O	微软	系统软件	28606.90	-1.38%	3.24%	-20.02%	22.85	7.32	700.66	764.41	776.73	812.73	828.86	258.24	272.33	277.47	384.58	317.74
INTC.O	英特尔	半导体产品	5520.56	-8.73%	-21.33%	197.87%	-173.93	4.96	126.67	128.59	136.53	136.74	135.77	-8.21	-29.18	40.63	-5.91	-37.28

资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

4.行业数据追踪

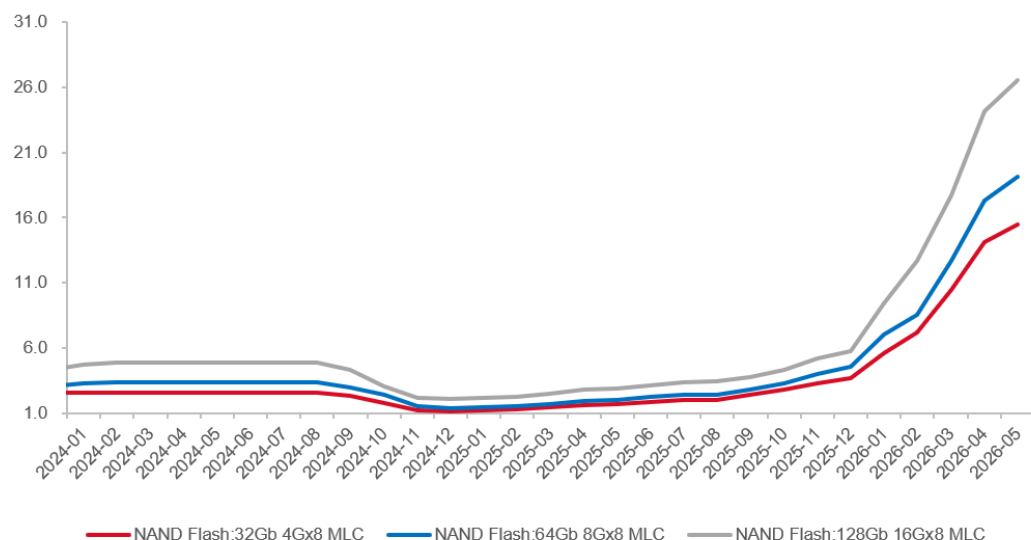
存储芯片价格自 2023 年下半年以来小幅度反弹，但自 2024 年 9 月起，DRAM 现货价格略有承压，部分 DRAM 细分产品价格自 2025 年 2 月中旬开始有所回升，波动上涨至 6 月，其中 6 月整体涨幅较大，DDR4 价格已升至 2022 年的前期高点，7 月起价格顶部震荡，9 月起价格持续上涨，2026 年 2 月起部分细分产品价格有所震荡。NAND Flash 合约价格在大下滑后于 2025 年 1 月回升，涨势已延续至 2026 年 7 月。

图8 2024 年 7 月 10 日-2026 年 7 月 10 日 DRAM 现货平均价（美元）



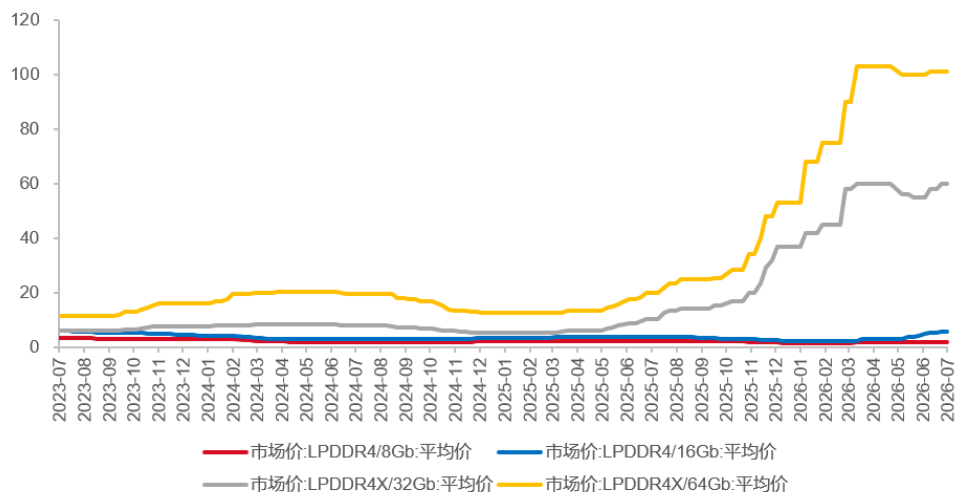
资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

图9 2024 年 1 月-2026 年 5 月 NAND FLASH 合约平均价（美元）



资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

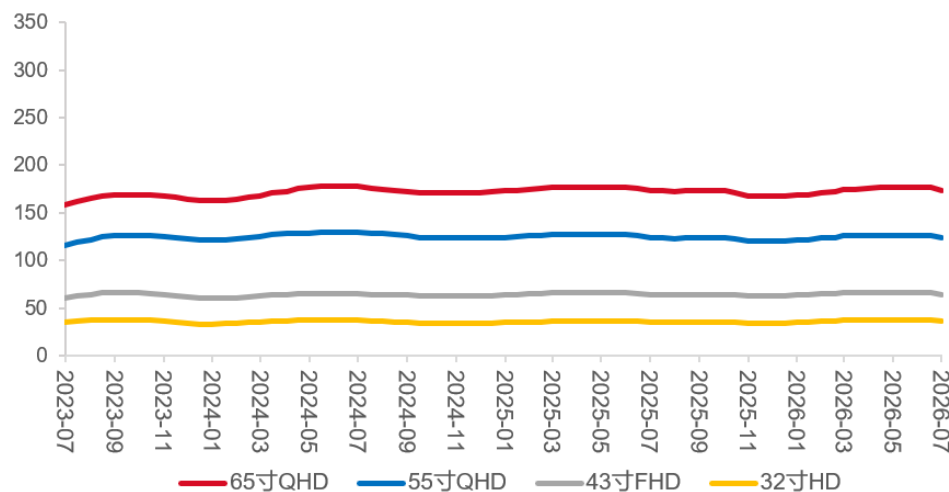
图10 2023年7月7日-2026年7月7日 LPDDR4/4X 市场平均价（美元）



资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

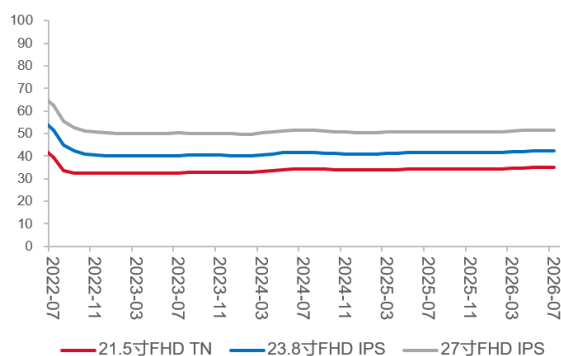
TV 面板、IT 面板价格逐渐稳定。

图11 2023年7月6日-2026年7月6日 TV 面板价格（美元）



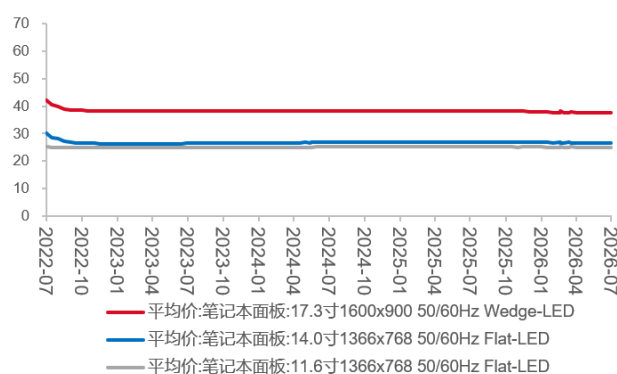
资料来源：集邦 Display，东海证券研究所

图12 2022年7月-2026年7月笔记本面板价格（美元）



资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

图13 2022年7月-2026年7月显示面板价格（美元）



资料来源：同花顺 iFind，东海证券研究所

5.风险提示

（1）下游终端需求复苏不及预期风险：下游需求复苏程度不及预期可能导致相关企业库存积压或相关工程建设进度放缓，并可能再度影响产业链内部分企业的稼动率；

（2）国产替代进程不及预期风险：国际贸易摩擦和相关进出口管制进一步升级，可能导致相关设备、原材料、零部件、核心专利技术紧缺，若国内相关产品替代程度不及预期，或将影响国内半导体产业链；

（3）AI 资本开支不及预期风险：AI 算力需求为当前半导体增长核心，若宏观经济波动或 AI 应用商业化落地慢于预期，导致云厂商及下游企业资本开支收缩，或将直接影响 AI 芯片、HBM、先进封装等环节订单与业绩兑现节奏。

一、评级说明

	评级	说明
市场指数评级	看多	未来 6 个月内上证综指上升幅度达到或超过 20%
	看平	未来 6 个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间
	看空	未来 6 个月内上证综指下跌幅度达到或超过 20%
行业指数评级	超配	未来 6 个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	标配	未来 6 个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	低配	未来 6 个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%
公司股票评级	买入	未来 6 个月内股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	未来 6 个月内股价相对强于上证指数在 5%—15%之间
	中性	未来 6 个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	未来 6 个月内股价相对弱于上证指数 5%—15%之间
	卖出	未来 6 个月内股价相对弱于上证指数达到或超过 15%

二、分析师声明：

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证以专业严谨的研究方法和分析逻辑，采用合法合规的数据信息，审慎提出研究结论，独立、客观地出具本报告。

本报告中准确反映了署名分析师的个人研究观点和结论，不受任何第三方的授意或影响，其薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

署名分析师本人及直系亲属与本报告涉及的内容不存在任何利益关系。

三、免责声明：

本报告基于本公司研究所及研究人员认为合法合规的公开资料或实地调研的资料，但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究人员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海证券股份有限公司，或任何其附属或联营公司的立场，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下，本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读和参考。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的保证证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

四、资质声明：

东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构，已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者，参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。

五、联系方式：

地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦
 网址：Http://www.longone.com.cn
 座机：(8621) 20333275
 手机：18221956989
 传真：(8621) 50585608
 邮编：200125